

第 57 回 電子デバイス実装研究委員会



日時：2026 年 7 月 21 日（火）13:00～16:45

場所：日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室（東京都中央区）

プログラム

司会 西川 宏（大阪大学）

13:00～13:10 委員会議事

13:10～13:50

『フィジカル AI としてのモビリティと機器・実装の動向』（40 分）

.....○三宅 敏広（車載エレクトロニクス実装研究所）

13:50～14:30

『ポーラス金属の構造制御による熱伝導率の向上と熱マネジメントへの応用』（40 分）

.....○小林 亮平、三谷 敦己、前田 徹（住友電気工業株式会社アドバンストマテリアル研究所）

14:30～14:45 休憩

司会 作山 誠樹（Rapidus 株式会社）

14:45～15:25

『WBG パワーモジュール実装に向けた高放熱・高信頼複合基板の開発と応用』（40 分）

.....○津島 栄樹（株式会社 FJ コンポジット）

15:25～16:05

『多孔質銅めっき皮膜を用いたセラミック基板のクラック抑制』（40 分）

.....○長尾 敏光、中川 穂乃佳、広岡 和洋（奥野製薬工業株式会社 総合技術研究所）

16:05～16:45

『半導体レーザはんだ付けにおける放射温度制御』（40 分）

.....○浅葉 耕平（株式会社ジャパンユニックス 技術開発部）

（ ）内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。
一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会